

# 先進半導体生産技術の最前線

～ CMP とリソグラフィー/ナノインプリント技術の新たな挑戦 ～

当専門委員会では、4部会で年1回ずつ研究会を開催しています。第2回研究会は、先端生産技術部会の企画研究会です。当部会は第一線でご活躍の技術者、優れた実績をもつ高名な研究者の皆様をお招きし、最先端の生産技術/研究をご披露頂きます。その後は、新技術/研究の神髄に迫るべく、深く議論を交わして参りたく存じます。今回は半導体生産技術のうち、CMP技術研究の最前線について、九州大学名誉教授の土肥俊郎先生、産総研の河田研治先生にご講演をお願いしました。また、リソグラフィー/ナノインプリント技術の最前線については、旭化成 PED プロジェクト長の阿部誠之様、キヤノンの丸山洋之様にご講演をお願いしました。活発なご討論をよろしくお願い申し上げます。

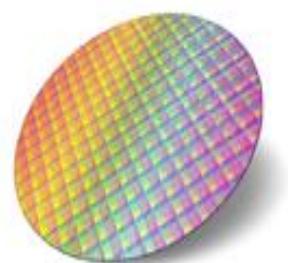
主催：公益社団法人精密工学会 生産原論専門委員会

協賛：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会  
レーザ協会

日時：2022年8月23日(火) 13:00～17:00

開催方式：Webex オンライン開催

※開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



13:00～13:05	開会挨拶	企画担当 谷口 淳氏 (東京理科大学)	
13:05～13:55	講演1	超精密 CMP 技術の理解と Beyond CMP 探求	九州大学・名誉教授 土肥 俊郎氏
14:00～14:50	講演2	パワーデバイス用 SiC ウェハの研磨加工	産総研・招聘研究員 河田 研治氏
14:50～15:00	休憩		
15:00～15:50	講演3	R2R サブミクロン解像度パターニング技術の紹介とエレクトロニクスデバイスへの応用	旭化成・PED-PJ 長 阿部 誠之氏
15:55～16:45	講演4	Nanoimprint Lithography 技術動向と将来展望	キヤノン・丸山 洋之氏
16:50～17:00	閉会挨拶・事務連絡	委員長 池野順一氏 (埼玉大学)	

## 参加費

・研究会：当専門委員会会員：無料、協賛団体：3,000 円、そのほか非会員：5,000 円

申込締切日：2022年8月16日(火)17:00

(注) 振り込みが確認できましたら、会議 URL をお知らせしております。  
ご了承下さいますようお願いいたします。

## 問合せ/申込先：

・レーザ協会事務局 田附 宙美宛  
FAX 048-829-7046 e-mail : laser@mech.saitama-u.ac.jp